

## 关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨 2026 年度“提质 增效重回报”专项行动方案的议案

各位董事：

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2025 年 4 月 24 日发布《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司 2025 年度提质增效重回报行动制定明确的工作方向。过去一年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年全年的主要工作成果暨 2026 年度行动方案报告如下：

### 一、坚守主业拓新局，核心技术筑牢高端制造竞争优势

2025 年全球高端制造稳步复苏，AI 算力持续爆发、数据中心规模化扩容及汽车智能化深度渗透，半导体、先进封装与 PCB 行业需求保持旺盛，高端国产替代进程全面深化。公司依托深厚的微纳直写光刻技术积淀，持续加速产品迭代与技术创新，推出适配芯片制造、先进封装及新能源汽车等核心场景的高端设备，稳步深化境内外市场布局；同时强化产业链协同合作，持续优化全球供应链体系，构建技术引领+高效响应的全球化竞争优势，坚定迈向微纳直写光刻领域国际领军企业，为全球高端制造产业注入持续创新动能。报告期内公司经营保持稳健增长，在技术突破、市场开拓、产业协同等方面取得显著进展，核心竞争壁垒持续加固。

#### 1、PCB 业务提质扩圈：高端突破+智能升级+全球拓展

2025 年公司持续推进 PCB 主业高端化升级，通过持续技术攻坚实现 HDI 板、类载板、IC 载板等高端 PCB 设备市场份额稳步提升，依托具备 3-4  $\mu\text{m}$  线宽制程能力的 MAS 系列设备持续巩固国内领先地位。受益于 AI 服务器、智能驾驶、先进封装等领域需求持续放量，高阶产品订单保持强劲增长，市场竞争力进一步凸显。在国际化战略层面，公司全球布局成效持续释放，泰国子公司运营成熟，深度承接东南亚 PCB 产业转移红利，推动东南亚地区营收占比稳步攀升；同时与鹏鼎控股、日本 VTEC 等国际头部客户战略合作持续深化，实现高端设备在海外市

场的规模化、批量化交付。报告期内，公司大客户战略成效显著，在巩固与鹏鼎控股、胜宏科技等行业龙头深度合作的基础上，京东方供应链体系合作持续落地，标杆客户示范效应持续放大，为后续规模化扩张与全球化竞争筑牢坚实根基。

2026 年公司将持续推进 PCB 领域智能化升级与高端化延伸战略，在产品端聚焦激光加工技术深度融合应用，通过迭代优化 UV 激光钻、CO<sub>2</sub>激光钻参数与核心工艺，进一步提升高多层板、HDI 板等高端产品钻孔精度与生产效率，持续强化激光钻孔细分市场领先优势；针对 FPC 轻薄化、柔性化发展趋势，持续优化升级 RTR-NEX 设备，通过结构创新与控制系统迭代，全面提升曝光精度与适配性，精准满足消费电子、汽车电子等领域对柔性电路板的高阶需求。技术开发端实现多点突破，持续优化 PCB 整机系统对位模型并深化算法应用，大幅提升多层板对位精度；研发落地新一代全自动标定方案，有效突破设备调试效率瓶颈；通过全平台子系统可靠性强化测试与专项性能优化，全面提升设备长时间连续稳定运行能力，为 PCB 业务高端化、智能化、全球化发展筑牢核心技术底座。

## 2、泛半导体多线协同发力，高端制造国产替代提速增效

2025 年公司持续深化泛半导体及高端制造领域战略布局，泛半导体业务成长为核心增长曲线。IC 载板领域凭借 3-4 μm 高解析度技术实现国产替代，MAS4 设备完成客户端批量验证并落地量产，MAS 6P 在头部客户完成验收并投入量产，NEX 30 解决方案全面支撑高阶 HDI 及 IC 载板大规模量产，定增项目与二期产能同步释放，有力支撑产能扩张与海外市场交付；先进封装领域紧跟 AI 芯片与先进封装浪潮，WLP 晶圆级封装设备实现批量交付并助力头部厂商类 CoWoS-L 量产，PLP 板级封装设备实现产能效率与成品率双重提升，斩获批量重复订单；掩膜版制版业务加快 90nm-65nm 节点设备研发与验证，构建设备到工艺的全链条技术壁垒；引线框架领域以高精度蚀刻工艺替代传统冲压，超薄产品批量导入核心客户供应链；功率半导体领域 MLF 系列数字光刻设备海外订单持续增长，日本等海外市场放量落地；新型显示领域围绕 Mini/Micro-LED 迭代 NEX-W 机型，深度稳固京东方等头部客户合作，屏幕传感器 RTR 及 LCD 制程设备国际订单稳步增长，高端显示装备市场地位持续巩固。

2026 年公司在泛半导体领域全面聚焦技术迭代与规模放量，产品端深耕晶

圆级封装、MLC 系列、LDW 及 IC 载板核心赛道，迭代升级 WLP 系列高端封装设备，优化大尺寸晶圆曝光工艺，助力先进封装量产爬坡；推出高性价比模块化 MLC Lite 设备，进一步拓宽泛半导体光刻应用场景；通过光学系统与算法深度优化，升级 LDW 350 设备解析度与加工速度，精准匹配先进芯片制造及掩模版制版高端需求；持续升级 IC 载板设备光学与运动控制技术，加速抢占中高端市场份额。技术底座持续夯实，搭建统一软件公共平台整合智能控制与数据管理功能，持续强化设备智能化水平与核心技术壁垒，为泛半导体业务高质量增长提供强劲支撑。

## 二、深化数智体系建设，驱动高质量发展

2025 年公司全面落地数智化升级战略，搭建覆盖研发、制造、供应链、营销、财务全业务场景的一体化数字平台，推动数据治理与业务流程深度融合。研发环节，加速 IPD 研发体系落地与 PLM 系统迭代，完善产品平台化开发与矩阵式管理机制，强化知识产权全周期布局，显著提升研发效率与技术成果转化速度。营销服务领域，深化 CRM 系统应用，实现市场开拓、销售履约、客户服务全流程可视化管理，优化客户生命周期运营，提升客户满意度与忠诚度。财务管理方面，全面启用智能费控系统，构建费用全流程闭环管控体系，实现成本精准管控与经营风险有效防范。智能制造与供应链板块，推进 SRM 供应商管理、WMS 仓储管理系统建设，打造一站式采购协同平台，配合二期工厂智能化投产，夯实精益制造与高效供应链基础。通过全方位数智化变革，公司运营效率、产品品质与经营管控能力持续提升，为全球化扩张与规模化发展筑牢数字支撑。

2026 年，公司将以数智化创新为核心引擎，从研发、营销、制造、管理四大维度推动数字化转型向纵深进阶。研发端，深度融合 IPD 与 PLM 系统能力，搭建标准化研发流程与模块化技术平台，引入 AI 辅助设计，强化核心技术研发与知识产权保护。营销端，推进智慧 CRM 系统全球化升级，构建全球客户生态管理体系，精准挖掘市场商机，提升订单转化与客户价值。制造端，加速供应链全链路数字化改造，完善供应商协同与智能采购平台，优化仓储物流与生产配套效率，打造智能工厂标杆。管理端，持续深化业财一体化建设，搭建数字化经营分析与费用管控平台，实现流程自动化、决策数据化，有效防控经营与税务风险，以数

智能化能力全面驱动公司精细化管理与高质量发展。

### **三、坚守价值创造初心，持续提升股东回报**

公司秉持“价值创造为本、利益共享为纲”的核心发展理念，构建起资本市场回报与战略发展深度协同的双向赋能机制，全年持续强化价值创造，通过现金分红、长效激励等多种方式，提升股东回报，实现公司、股东与核心团队的利益共享、风险共担。

报告期内，公司以总股本剔除回购股份后的 131,263,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税），共派发现金红利共计 48,567,455.78 元，本次现金分红总额占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.22%。公司持续实施积极合理的利润分配方案，在保障自身稳健经营与持续创新发展的同时，切实将经营成果转化为实实在在的股东回报，以制度化、可持续的分红机制稳定投资者预期，充分彰显与全体股东共享高质量发展成果的责任与担当。

长效激励方面，公司顺利推出 2025 年员工持股计划，进一步健全管理层与核心骨干同股东利益共担、风险共守、成果共享的长效绑定机制，通过科学的激励制度设计与公司治理结构持续优化，将核心团队绩效与公司经营业绩、股东长期回报深度挂钩，充分激发核心人才队伍的创新活力、凝聚力与战斗力，为公司长期高质量发展注入强劲内生动力。同时，公司积极推动市值管理与价值提升工作，依托业绩增长与市值稳步提升，持续增强股东长期投资回报，有力实现公司价值、员工价值与股东利益的协同增长。

2026 年，公司将严格遵照国家法律法规、监管要求及《公司章程》等相关规定，综合考量公司发展阶段、经营业绩、现金流状况与未来资金规划等多重因素，在满足利润分配条件的前提下，持续健全科学、稳定、可持续的股东回报机制，积极落实利润分配方案，以持续、稳定的投资回报切实维护全体股东尤其是中小公众投资者的合法权益，与广大投资者共享公司高质量发展成果。

### **四、强化公司治理建设，护航稳健发展**

报告期内，公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完善公司治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体如下：

### **1、健全监督体系，推动监事会与审计委员会职权平稳衔接**

公司持续优化内部监督治理架构，积极推动监事会职权与审计委员会职能有效过渡、顺畅衔接，明确双方监督职责边界与协同工作流程，在财务监督、内控审查、风险管控等领域形成联动合力，构建权责清晰、协同高效的监督体系，全面提升公司治理监督效能。

### **2、深化内控体系建设，适配境内外双重监管要求**

为扎实推进内部审计工作落地，强化内部控制、防范经营风险、优化经营管理，公司结合自身实际，建立健全内部审计制度，切实提升内部审计工作质量与监管力度。同时，公司加强全流程内控管理，严格对标港股上市监管标准，确保内控体系符合境内外双重监管要求，为合规经营提供坚实保障。

### **3、强化董监高合规履职能力建设**

公司组织董事、高级管理人员积极参与上交所等监管机构举办的各类合规培训，持续加强证券法律法规、监管规则及公司治理专业知识学习，不断提升合规自律意识与规范履职能力，保障公司持续规范运作。未来公司将持续为董监高参与各类专业合规培训提供全力支持，夯实公司规范治理的核心基础。

公司将始终坚守合规经营底线，持续完善内部控制与监督体系，自上而下强化合规建设，以现代化治理体系切实推动公司高质量可持续发展。2026年，公司将持续推进公司治理体系迭代升级，一是全面贯彻新《公司法》及证监会、交易所最新监管规则，同步适配港股上市治理要求，修订完善《公司章程》及配套治理制度，规范股东会、董事会运作机制，持续优化审计委员会职能，强化中小股东权益保护。二是深化内部控制体系建设，构建风险识别、评估、应对、监控全流程闭环管理机制，强化关键业务环节合规审查，实现合规经营与运营效率双提升。三是建立资本市场监管政策动态跟踪机制，紧跟信息披露、境外上市等新规要求，及时修订内部制度并开展专项合规培训，确保公司治理运作与最新监管要求同频同步。

### **五、加强募投项目管理，提升科技创新能力**

报告期内，在募投项目的实施过程中，公司持续严格遵守相关法规指引及《公司募集资金管理办法》的规定，审慎使用募集资金，加速推进募投项目建设，以募投项目的落地巩固并提升公司行业竞争地位，拓宽公司业务覆盖度的深度及广

度，敏锐把握市场发展机遇，实现公司主营业务的可持续发展。

2025年，公司将继续加快推进募投项目建设，争取早日达成并实现预期效益，以增强公司盈利水平。同时，公司将在目前业务稳步增长的同时，合理利用募集资金拓展业务创新机会，持续关注行业发展趋势，为客户提供更优质的产品，发掘新的利润增长点，在激烈的市场竞争中赢得先机。

## **六、提升信息披露质效 深化投资者沟通管理**

公司始终将信息披露与投资者关系管理作为重要工作，以高质量信息披露提升治理水平、增强市场透明度，持续传递公司价值。2025年，公司严格遵循境内外证券监管规则、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理制度，依法合规履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告、临时公告及各类重大信息，保障投资者知情权。公司持续优化披露文本结构与表述方式，使用简明易懂的语言，减少专业晦涩表述，进一步提升信息披露的可读性与有效性。

公司在定期报告披露后，常态化通过业绩说明会、图文解读简报等可视化形式，对经营成果、财务状况与发展战略进行直观解读，帮助投资者更清晰理解公司核心价值。为构建高效双向沟通机制，公司畅通投资者专线、专属邮箱及“上证e互动”平台等沟通渠道，及时响应投资者咨询与关切；积极开展投资者调研交流活动，在合规前提下与投资者面对面沟通，增进市场对公司的理解与信任，切实维护投资者合法权益。

2026年，公司将持续完善信息披露管理体系，严格对标科创板与香港联交所双重监管标准，不断提升披露质量与规范性。公司将充分运用投资者专线、邮箱、官网投资者专栏、上证e互动等多元渠道，高效回应投资者关切；定期报告披露后常态化召开业绩说明会，邀请董事、管理层与投资者深度交流。同时，公司将积极组织及参与线上线下调研、机构路演、行业策略会等活动，持续拓宽沟通边界、优化沟通体验，以透明高效的投资者关系管理助力公司高质量发展

## **七、压实关键少数责任，健全利益共担机制**

报告期内，公司实际控制人不存在侵占公司资产、损害公司和中小投资者利益的情况，在业务、人员、资产等方面与公司保持独立。公司通过独立董事等多层级多维度对“关键少数”人员在公司核心重点领域进行监督。公司全力支持董

事、高级管理人员积极参与监管机构举办的各种线上、线下培训，在监管规则发生重大变更时主动发起并组织相关培训，加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的学习，增加合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。

2026 年公司将结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评，将高管薪酬与公司经营业绩相挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。将公司高级管理人员业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益相结合。进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识 and 责任担当，推动公司的长期稳定发展。

## **八、推进 H 股发行上市，赋能全球化新征程**

2025 年 8 月，公司已向香港联合交易所有限公司递交了发行 H 股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，截至 2026 年 2 月 6 日，公司关于发行境外上市股份（H 股）已获中国证监会备案，拟发行不超过 2673.57 万股境外上市普通股，备案有效期 12 个月，后续尚需监管机构、证券交易所相关机构批准，标志着公司 H 股上市计划进入关键阶段，公司将全力以赴加快推进港股上市进程。

此次 H 股上市的核心目标在于依托香港国际金融中心优势，拓宽国际融资渠道，募集资金将主要用于研发升级、产能扩张、海外销售网络建设及战略投资收购；同时，借助港股治理标准提升品牌国际认可度，加速东南亚等海外业务布局，强化公司在微纳直写光刻领域的国际竞争力。

## **九、其它事宜**

公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象，促进公司的平稳健康发展。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2026年3月13日